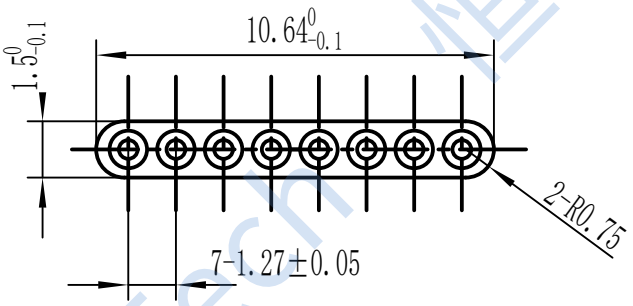

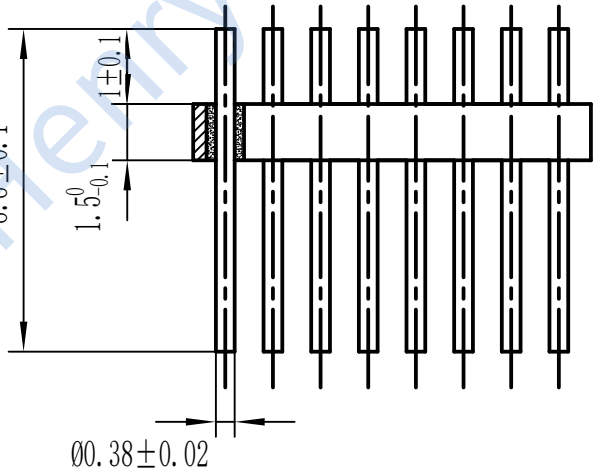

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^{3} /S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥1.27μm软金

借通用件登记							
描 图							
校 描							
旧底图总号							
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期	装配图	HN-LP8-0.38-1.27(8.8-1)M
日 期	设计	M.	标准化			图样标记 / 重量 / 比例	成都恒利泰科技有限公司
	审核					1:1	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	工艺		日期			共 页 / 第 页	

恒利泰 HenryTech